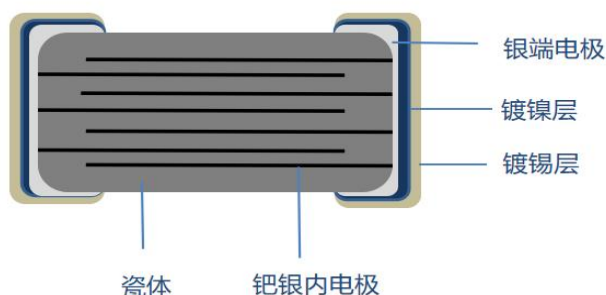


■ 片式元器件用钯银内电极浆料

◆ 特征

- * 灰黑色膏状流体，主要由钯银粉、树脂和溶剂组成，不含铅、隔、铬等有害物质，符合 Rohs 环保要求。
- * 分散性能优良，无团聚。
- * 印刷电极光滑平整，厚度均匀，连续性好，与瓷体收缩匹配性良好。

◆ 产品在片式元器件中应用示意图及产品图片



◆ 物理性能

型号	固含量 (%)	金属比例 (%) (Ag/Pd)	粘度* (Pa·S)	细度 (第二刻线/90%)	适用性
E-1150	54.0±1.5	0/100	10.0~30.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	2525~3838 规格 MLCC 产品
E-2360BT	60.0±0.5	70/30	16.0~19.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	C0G 瓷料, 0603 以上规格 MLCC 产品
E-2369BT	60.0±0.5	70/30	15.5~18.5	≤ (6.0μm /5.0μm)	C0G 瓷料, 0603 以上规格 MLCC 产品
E-2369ET	52.5±1.0	70/30	12.5~14.5	≤ (6.0μm /5.0μm)	X7R、C0G 瓷料, 0603 以上规格 MLCC 产品
E-2255	55.0±1.0	80/20	12.0~15.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	C0G 瓷料, 0603 以上规格 MLCC 产品
E-2246	51.0±1.0	85/15	10.0~12.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	Y5V、X7R 瓷料, 0603 以上规格 MLCC 产品
E-2160S	60.0±1.0	90/10	12.0~14.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	Y5V 瓷料, 0603 以上规格 MLCC 产品
E-2160H	60.0±1.0	90/10	18.0~24.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	Y5V 瓷料, 0603 以上规格 MLCC 产品
E-20560	60.0±1.0	95/5	10.0~25.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	片式压敏电阻器
E-20260	64.5±1.0	98/2	30.0~40.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	片式压敏电阻器
E-2160DG	60.0±1.0	90/10	12.0~16.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	片式压敏电阻器
E-2369EH	52.5±1.0	70/30	25.0~31.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	片式压敏电阻器
E-2355EH	56.5±1.0	70/30	25.0~35.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	片式压敏电阻器
E-20563	62.5±1.0	95/5	23.0~29.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	片式压敏电阻器
E-2369GY	60.0±1.5	70/30	55.0~75.0	≤ (6.0μm /5.0μm)	片式压电陶瓷驱动器

(注*: 粘度检测条件为 Brookfield HBDV-II +, CP52, 25±0.5℃, 10rpm)

◆ 产品特点

*1998 年我司在国内率先实现了钯银电极浆料匹配 NME-MLCC 材料的产业化，浆料用的关键材料——钯银金属粉体为自制产品，可依照客户需求定制不同钯银比例的浆料。

◆ 推荐工艺

* 搅 拌：使用前慢速搅拌均匀。

* 丝 印：325~500 目不锈钢丝网或尼龙丝网，丝印烧结后电极厚度为 1~5μm。

* 烧 结：推荐峰值温度及保温时间如下：

型号	烧结温度范围 (°C)	保温时间 (hr)
E-1150	1445±75	3
E-2360BT	1120±30	3
E-2369BT	1120±30	3
E-2369ET	1120±30	3
E-2255	1030±30	3
E-2246	990±30	3
E-2160S	950±50	3
E-2160H	950±50	3
E-20260	890±30	3
E-20560	930±30	3
E-2160DG	950±30	3
E-2369EH	1120±30	3
E-2355EH	1120±30	3
E-20563	930±30	3
E-2369GY	1120±30	3

◆ 产品使用注意事项

* 清 洗：建议使用无水乙醇清洗。

* 储 存：建议在温度 18~25℃、湿度≤75%环境密封储存，避免置于阳光直射或含有腐蚀性气体环境中。

* 有 效 期：建议在符合上述储存条件下 9 个月内使用。

* 包装规范：采用 PE 塑料瓶，500g/瓶或 1000g/瓶或 1500g/瓶。